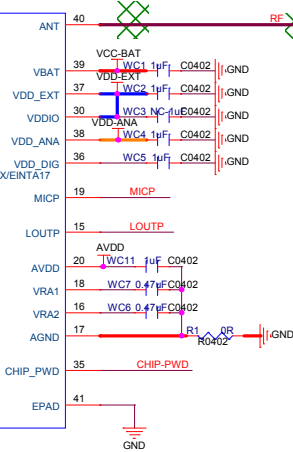
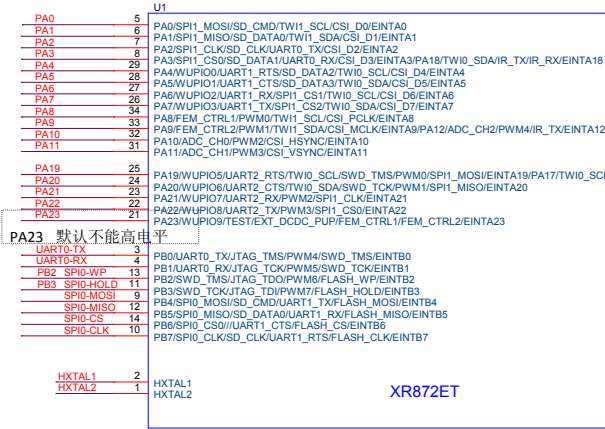


REF1:

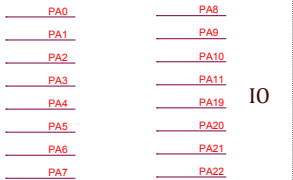
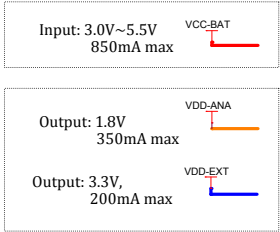
- 1. VCC-BAT输入 3.0V~5.5V 的情况。
- 2. Flash 和 VDD_IO 选用 3.3V.



RF走线需 50 欧姆阻抗控制



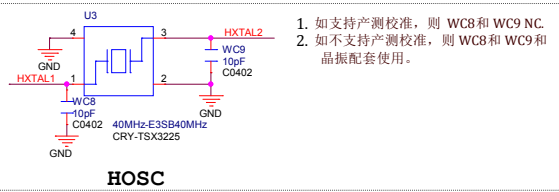
注: 1. NC 是默认不贴。
2. 旁路电容靠近图上 Pin 位置。



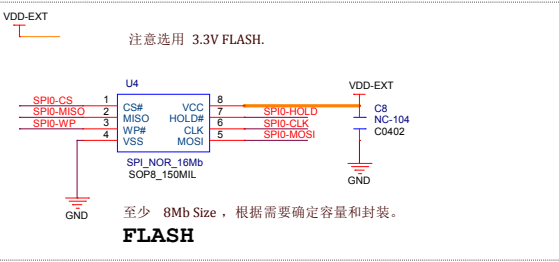
芯片启动时，当 PB2 和 PB3 都为低，系统强制进入烧写模式。

默认（芯片启动时）不能高电平。

如不需要用 CHIP-PWD，则把 CHIP-PWD 上拉至 VCC-BAT.



- 1. 如支持产测校准，则 WC8和 WC9 NC.
- 2. 如不支持产测校准，则 WC8和 WC9和晶振配套使用。



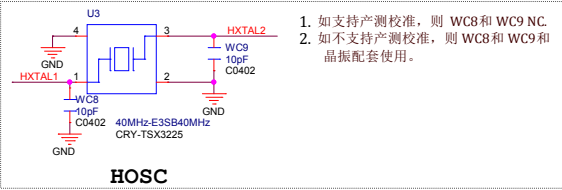
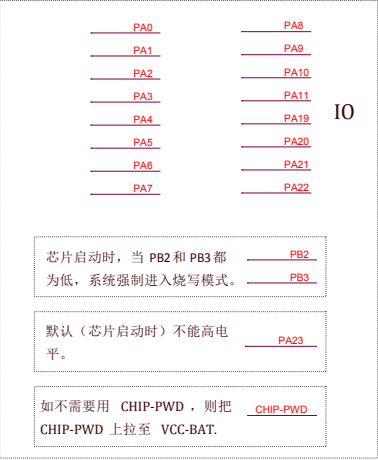
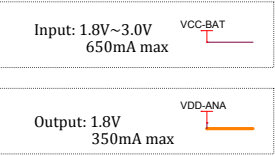
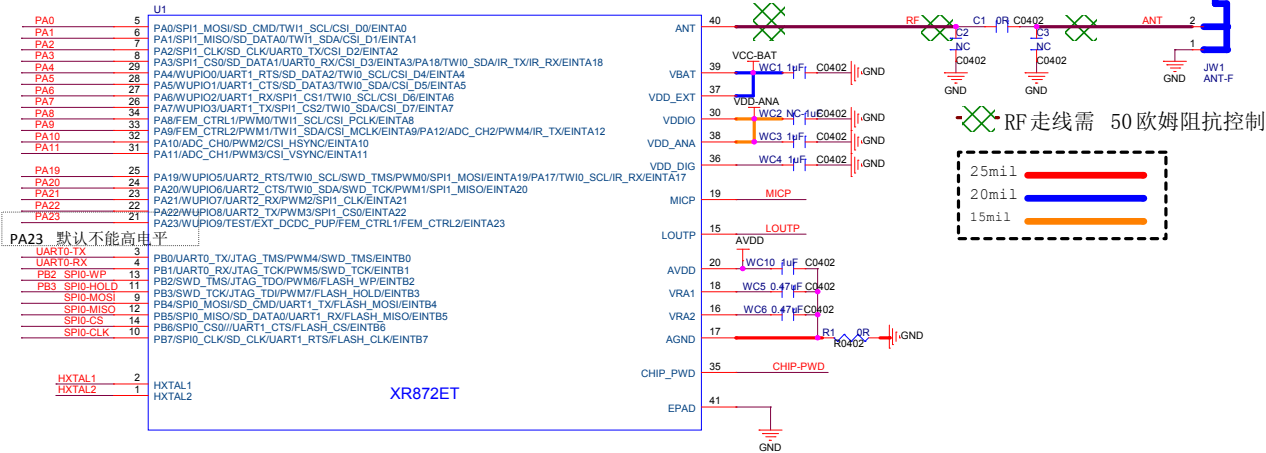
至少 8Mb Size，根据需要确定容量和封装。



AUDIO

REF2 :

- 1. VCC-BAT输入 1.8V~3.0V 的情况。
- 2. Flash 和 VDD_IO 选用 1.8V.



- 1. 如支持产测校准，则 W8和 W9 NC.
- 2. 如不支持产测校准，则 W8和 W9和晶振配套使用。

